

# **DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UNA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO DE UN CONVERTIDOR DE POTENCIA AISLADO PARA SISTEMA EXPERIMENTAL DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS HÍBRIDOS**

**Práctica Profesional Supervisada  
Tomás Tavella**



**Ing. Jorge L. Anderson**  
**DOCENTE**  
**SUPERVISOR**

**INSTITUTO LEICI**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**UNLP**

**Ing. Claus Mancini**  
**PROFESIONAL**  
**RESPONSABLE**



# RESUMEN

Este trabajo consiste del diseño y fabricación de una placa de circuito impreso o PCB (del inglés *Printed Circuit Board*) para el convertidor de potencia aislado de una plataforma experimental de evaluación de sistemas híbridos. Se debe implementar un circuito de alta complejidad, de más de 150 componentes discretos, en una PCB de doble capa (doble faz) de dimensiones reducidas. Para estas tareas, se utilizó la herramienta de automatización de diseño electrónico (EDA, del inglés *Electronic Design Automation*) KiCad, un software libre y gratuito de nivel profesional.



# ÍNDICE

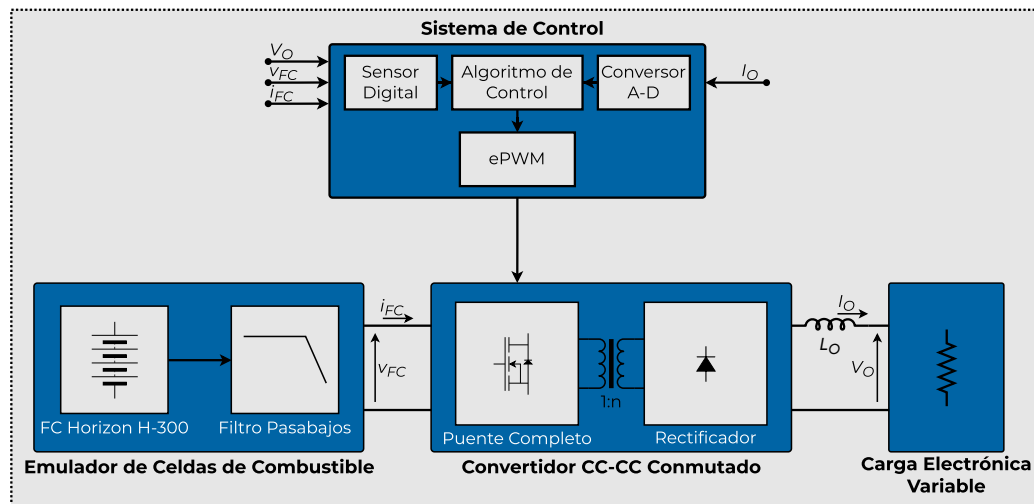
<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO</b>	<b>7</b>
2.1	Descripción Circuital . . . . .	8
2.1.1	Convertidor CC-CC Conmutado . . . . .	8
2.1.2	Circuito Driver . . . . .	8
2.1.3	Sistema de Medición . . . . .	9
2.1.4	Etapa de Aislación de Señal. . . . .	9
2.1.5	Sistema de Control. . . . .	9
2.1.6	Circuito de Alimentación. . . . .	9
2.2	Consideraciones Generales. . . . .	10
2.2.1	Software EDA . . . . .	10
2.2.2	Aislación de Tierras. . . . .	10
2.2.3	Selección de Componentes. . . . .	10
2.2.4	Ancho de Pistas. . . . .	11
2.3	Implementación en PCB . . . . .	12
2.3.1	Listado de Componentes . . . . .	12
2.3.2	Ubicación y Disposición de Circuitos. . . . .	14
	<b>REFERENCIAS</b>	<b>19</b>



# INTRODUCCIÓN

## CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA EXPERIMENTAL Y LOS BLOQUES QUE LA COMPONENTEN

Previo a comenzar con el diseño de la placa de circuito impreso, debemos introducir la plataforma que se tiene que plasmar en esta PCB, explicando brevemente su funcionamiento y los bloques principales y auxiliares que la componen. Se puede apreciar un diagrama de esta plataforma, separada en sus distintos bloques funcionales en la figura 1.1.



**FIGURA 1.1** Diagrama de la plataforma experimental de evaluación de celdas de combustible.

Esta plataforma, como indica su nombre, tiene como objetivo la evaluación empírica de sistemas híbridos, que son sistemas de generación de energía que combinan múltiples módulos de generación y almacenamiento de energía, generalmente renovables, que luego son todos conectados a un bus de potencia, generalmente de corriente continua (CC).

Particularmente, este sistema evalúa el rendimiento de un módulo de generación a partir de pilas de combustible, con una tensión de pila en la entrada  $V_{FC}$  variable entre 30 V y 65 V, y una tensión de salida común fija de 75 V. Para realizar esta adaptación de niveles de tensión, se utilizó un convertidor CC-CC conmutado y aislado de tipo puente completo, que es controlado mediante el sistema de control basado en un controlador digital de señales (DSC, del inglés *Digital Signal Controller*).

Los circuitos de estos bloques y el resto de bloques auxiliares de la figura 1.1 se van a tratar uno por uno a lo largo del desarrollo de este informe, detallando su diagramas circuitales y como estos se implementaron en la plaqueta.

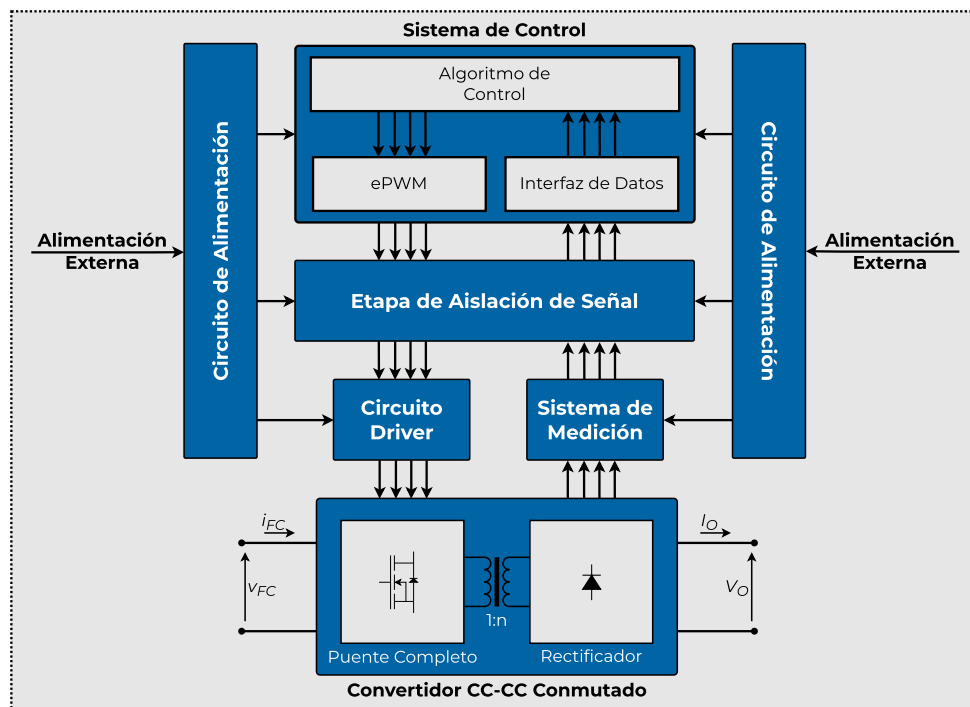




## DESARROLLO

### DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO DE LA PLATAFORMA DE EVALUACIÓN

En este capítulo vamos a tratar la implementación de la plataforma experimental completa de la figura 2.1 sobre una placa de circuito impreso. Dada la complejidad de todos los circuitos de este sistema, con una cantidad de componentes que supera los 150, se decidió implementar una PCB doble faz o doble capa, con unas dimensiones de aproximadamente 15 cm x 15 cm. En tanto a su construcción, se utiliza el sustrato FR-4 estándar (laminado de resina epoxi reforzado con vidrio) y vías de tipo PTH (del inglés *Plated Through-Hole*).



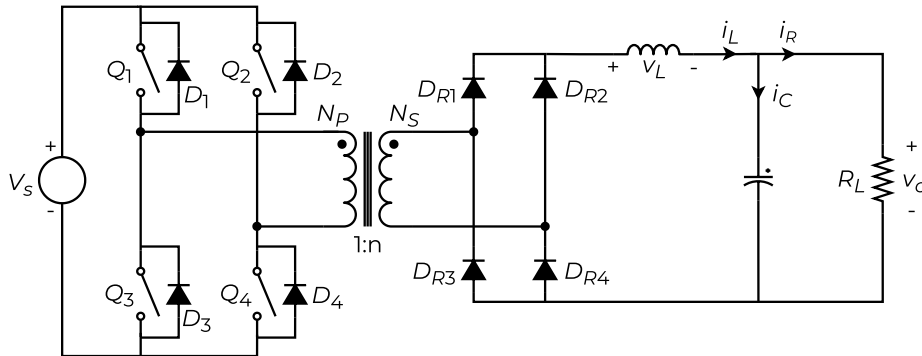
**FIGURA 2.1** Diagrama detallado de la plataforma experimental de evaluación, con los seis bloques que la componen.

Como se ve en el diagrama detallado de la plataforma, esta cuenta con seis bloques principales a ser implementados en la plaqueta: los dos bloques principales (el convertidor y el bloque de control) y los cuatro bloques auxiliares restantes que se encargan de diversas tareas como la adquisición de datos y la alimentación de los circuitos, entre otras. Vamos a comenzar por una breve descripción de los circuitos de cada bloque y sus componentes, para luego pasar a la implementación de todos estos en la PCB, tomando en cuenta algunas consideraciones generales de diseño de PCB que vamos a establecer.

## 2.1 DESCRIPCIÓN CIRCUITAL

### 2.1.1 CONVERTIDOR CC-CC CONMUTADO

En la figura 2.2 se presenta el circuito completo del convertidor CC-CC conmutado y aislado de tipo puente completo que se utiliza en la plataforma. Consiste de un puente de llaves con diodos en antiparalelo a cada una (de  $Q_1$  a  $Q_4$ ). Luego se encuentra un transformador de alta frecuencia que aísla los lados primario y secundario. El puente de diodos del secundario se encarga de generar una forma de onda rectificadas, que es luego filtrada por el circuito LC y llevada en forma de corriente continua a la carga  $R_L$ .

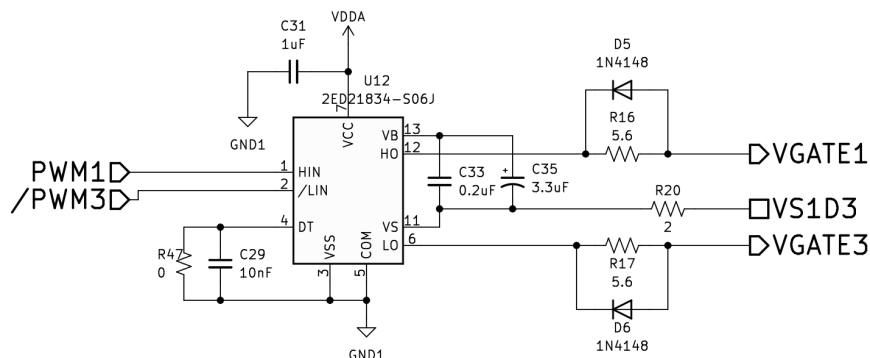


**FIGURA 2.2** Diagrama del convertidor CC-CC de tipo puente completo a utilizar, con todos sus componentes.

La funcionalidad de las llaves del primario es llevada a cabo por transistores MOS-FET de potencia, cuyo modelo específico se trata más adelante. El lado primario y secundario se conectan a masas distintas ( $GND_1$  y  $GND_2$  respectivamente), ambas en el lado de potencia de la plataforma.

## 2.1.2 CIRCUITO DRIVER

El circuito driver de la plataforma es el encargado de proveer los pulsos de tensión y corriente necesarios para excitar los MOSFET del puente de transistores y conmutarlos adecuadamente. Esta excitación es comandada por el sistema de control e ingresa por el tercer terminal de cada transistor, en este caso el *gate*. Se observa el cricuito driver para una rama de transistores en la figura 2.3.



**FIGURA 2.3** Circuito de conexión del driver 2ED21834-S06J. El circuito del driver para la otra columna es idéntico.

Si bien es posible diseñar un sistema de excitación con componentes discretos, resulta más sencillo y confiable utilizar componentes integrados que se encargan de

realizar esta función, como el componente U12 que se observa en la figura (los componentes discretos que lo rodean están posicionados y dimensionados según recomendación del fabricante). Al estar encargado de la excitación de los transistores del primario, este circuito se encuentra puesto a tierra mediante la tierra primaria de potencia  $GND_1$ . Además, como el circuito de arriba es únicamente para una rama, se utiliza otro circuito idéntico para la rama restante de transistores.

### 2.1.3 SISTEMA DE MEDICIÓN

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

### 2.1.4 ETAPA DE AISLACIÓN DE SEÑAL

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

### 2.1.5 SISTEMA DE CONTROL

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

### 2.1.6 CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

## 2.2 CONSIDERACIONES GENERALES

### 2.2.1 SOFTWARE EDA

Para realizar el diseño de todos los esquemas circuitales del sistema, y luego plasmarlos a una placa de circuito impreso se debe utilizar un herramienta de automatización de diseño electrónico o EDA (del inglés *Electronic Design Automation*). Existe una gran variedad de programas que cumplen este propósito, estando entre los más conocidos el *Altium Designer* de *Altium*, el *EAGLE* de *Autodesk*, el *KiCad* y el *Proteus Design Suite* de *Labcenter Electronics*.

Para este proyecto se eligió utilizar la plataforma **KiCad** (que se encuentra en la versión 6.0.7 al momento de escribir este informe), una suite de software libre, gratuita y de código abierto que incluye todas la funcionalidades necesarias para el diseño electrónico. Cuenta con herramientas de captura de esquemático, diseño de PCB, simulación mediante SPICE o Ngspice, visualización de archivos de fabricación y cálculos de diseño de PCB.



FIGURA 2.4 Logotipo de la plataforma KiCad EDA.

El programa también cuenta con una extensa biblioteca de componentes y *footprints* (son las “huellas” de los componentes en el circuito impreso) y la capacidad de crear o importar bibliotecas. Además tiene la capacidad de generar archivos de fabricación, modelos tridimensionales de la PCB y una *bill of materials* (lista de componentes).

### 2.2.2 AISLACIÓN DE TIERRAS

En toda la plataforma se va a trabajar con tres puestas a tierra distintas y aisladas entre sí:  $GND_1$  es la tierra del primario del convertidor,  $GND_2$  es la tierra del secundario del convertidor, y  $GND_D$  es la tierra de las partes de señal y digitales, como los sensores y el DSC.

Esto, si bien agrega una mayor complejidad al diseño, es ventajoso por múltiples razones. Primero, evita la generación de interferencia de modo común entre las tierras del convertidor ( $GND_1$  y  $GND_2$ ) que manejan altas corrientes y por lo tanto son más ruidosas; y la tierra de señal  $GND_D$  de más bajas corrientes que es más sensible al ruido. Además, dadas las altas corrientes del convertidor, esta separación permite la protección de los circuitos de señal ante picos de corriente y tensión inesperados en la parte de potencia.

En la PCB, las tierras se implementan mediante la funcionalidad de KiCad (y otros software EDA) llamada *fill zone* o rellenar zona, que permite elegir una zona en la placa que es rellenada de cobre en todos los lugares donde no existan otras pistas. Esto facilita la interconexión de todos los componentes, en especial dado que la gran mayoría de estos tienen al menos una conexión a tierra.

### 2.2.3 SELECCIÓN DE COMPONENTES

Para todos los componentes en los que sea posible, se eligieron encapsulados de tamaño reducido y de montaje superficial (SMD, del inglés *Surface Mounted Devices*).

Estos son encapsulados, que como su nombre indica, son montados sobre la superficie de la placa, sin necesidad de una perforación que la atraviese (como es el caso de la tecnología THT o *through-hole*). Esto facilita el ruteo de las pistas de cobre, dado que si una pista pasa por la capa opuesta de un componente SMD, no es necesario esquivar los pines del mismo, que se encuentran únicamente de un lado de la PCB.

Para componentes sencillos como capacitores, resistencias, diodos y LEDs, se elige, siempre que sea posible, los de tipo SMD de dimensiones 1206, que corresponden a un empaquetado de 3 mm x 1.5 mm.

## 2.2.4 ANCHO DE PISTAS

La selección de los anchos de las pistas de cobre de las distintas partes del circuito es un parámetro sumamente importante, y presenta una situación de compromiso entre la superficie ocupada por las pistas y su pérdida de potencia (y elevación de temperatura). Para realizar estos cálculos se utiliza la herramienta *PCB Calculator* incluida en la suite de KiCad, que tiene la capacidad de realizar múltiples cálculos de utilidad en el diseño de PCBs, incluido el cálculo de ancho de pista, basado en la ecuación definida por la norma IPC-2221.

$$I = K \cdot (\Delta T)^{0.44} \cdot (1550 \cdot W \cdot H)^{0.725} \quad (2.1)$$

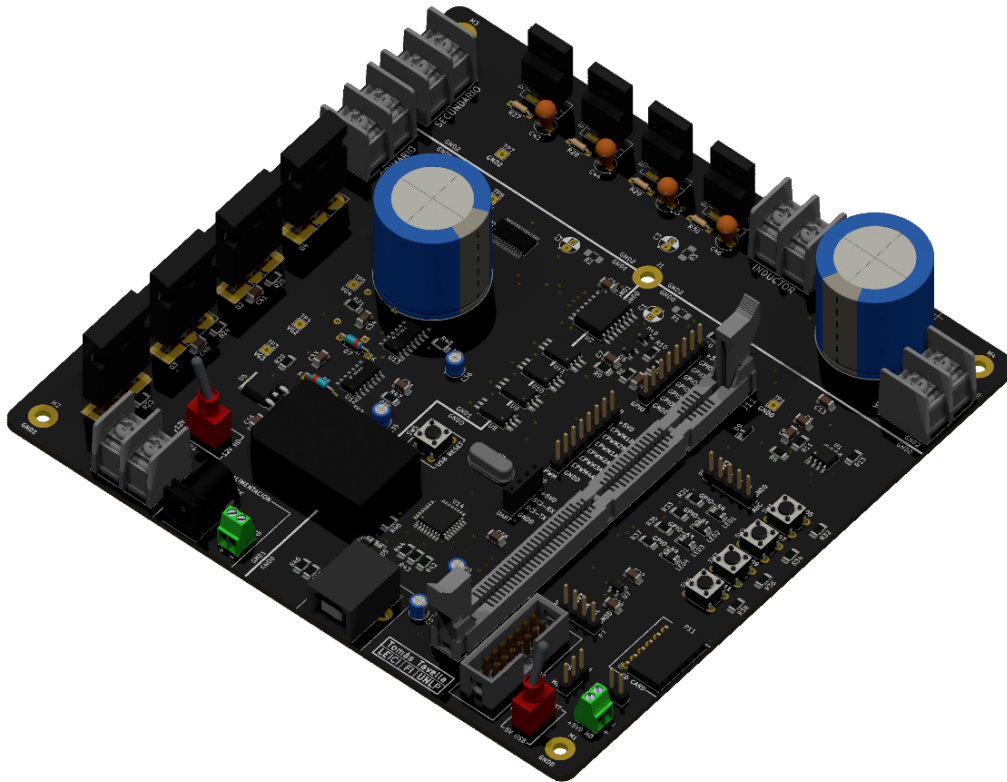
Donde  $I$  es la corriente que circula por la pista en [A],  $K$  es una constante definida por la norma de valor 0.048 para pistas externas,  $\Delta T$  es la elevación de temperatura de pista en [°C], y  $W$  y  $H$  son el ancho y grosor de la pista en [mm].

En nuestro caso, vamos a tomar un **grosor  $H$  fijo de 0,035 mm** para ambas capas de cobre, que es un valor estándar; y una **elevación de temperatura de pista máxima de 20 °C**. Con estos valores fijados, se calculará el ancho  $W$  de cada pista de la plaqueta.

Para las pistas de señal ubicadas en la parte digital de la plataforma, se decidió utilizar como estándar un ancho de pista  $W$  de 0.25 mm, que dadas las bajas corrientes que estas manejan (rara vez por encima de 100 mA), su temperatura no llega a elevarse ni 1 °C según la ecuación 2.1. Además, este es un ancho muy reducido, cercano a los límites de fabricación de múltiples fabricantes de placas locales.

## 2.3 IMPLEMENTACIÓN EN PCB

Una vez definidos todos los circuitos que componen a la plataforma, se llega a un total de **197 componentes** discretos con decenas de empaquetados distintos, que deben todos ser posicionados en una placa de circuito impreso doble faz del menor tamaño posible. El resultado final de la plaqueta, con todos sus componentes (exceptuando los disipadores térmicos de los transistores y diodos de potencia) se observa en la figura 2.5.



**FIGURA 2.5** Modelo tridimensional de la implementación en PCB de la plataforma con todos sus componentes, vista desde la parte superior.

Para comenzar, se va a realizar un listado de todos los componentes, clasificados según sus distintos encapsulados y sus *footprints* correspondientes (es la “huella” de cada componente sobre la plaqueta). Una vez establecido este listado, se procede a detallar el proceso de diseño de la placa de circuito impreso, comenzando por el posicionamiento de todos los componentes de la forma más compacta posible respetando la separación de tierras y dando el espacio necesario para el ruteo de pistas. Finalmente se conectan todos los componentes según indica el esquema circuital de la plataforma, y se realizan verificaciones finales previo a la generación de los archivos de fabricación definitivos.

### 2.3.1 LISTADO DE COMPONENTES

En la tabla 2.1 de la próxima página se presenta un listado de todos los componentes de la placa de circuito impreso, separados según su tipo de empaquetado, ya sea de montaje superficial (SMD) o de tipo through-hole (THT). Esto incluye circuitos integrados como los distintos sensores, resistencias y capacitores de todos los circuitos, transistores y diodos de potencia y auxiliares, y todos los distintos conectores de alimentación y señal.

	Empaquetado	Cantidad	Descripción
SMD	1206	85	Capacitores, Resistores y LED
	1210	1	Capacitor Tantalio
	3 x 5.4 mm	2	Capacitores Aluminio
	2512	1	Resistor Shunt
	SOIC-8	3	Sensor Hall y otros
	SOIC-16W	1	Aislador ISO7242C
	HTSSOP-28	1	Sensor LM5056A
	SSO-6	4	Optoacoplador ACPL-P480
	SO-14	2	Drivers 2ED21834-S06J
	LQFP-32	1	FTDI FT232BL
	SOD-123	1	Diodo Schottky
	SOT-23	3	Diodos Schottky y Transistores
	SOT-23-5	2	Reguladores Lineales
	TO-252-2	1	Regulador Lineal
THT	D25mm	2	Capacitores Electrolíticos 680 $\mu$ F
	D4mm	7	Capacitores Electrolíticos
	D4,5mm	4	Capacitores Tantalio
	D1,6mm x L3,6mm	4	Resistores
	TO-247AC	4	Transistores IRFP150
	TO-220	4	Diodos MUR860
	DIP-24	1	Fuente Aislada THB3-1211
	DO-35	4	Diodos
	HC-18	1	Cristal
	DIMM100	1	Conector DIMM para DSC
	DCJ200-10A	1	Barrel Jack
	USB-B	1	Conector USB-B Hembra
	Degson Screw Terminal	5	Conectores Pila, Carga, etc.
	Phoenix Contact 2P	2	Conectores 5V y 12V Externo
	Pulsador P6mm	5	Pulsadores
	Pin Header P2,54mm	34	Tiras de Pines
	Pin Header P2,54mm 2x7	1	Conector J-TAG
	Pin Socket P2,54mm	6	Conectores Pines Hembra
	Switch 3P P2,54mm	2	Interruptor de 3 Polos
Total		197	

**TABLA 2.1** Lista completa de componentes de la plataforma, clasificados según su tipo y modelo de encapsulado.

Ahora, todos estos componentes se deben posicionar de manera compacta en la placa doble faz de aproximadamente 15 cm de lado, y conectarse de acuerdo a los circuitos presentados en la sección anterior, teniendo en cuenta las consideraciones de ancho de pista y conexión de tierras.

## 2.3.2 UBICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE CIRCUITOS

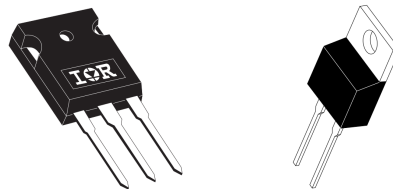
Para ubicar los componentes en la plaqueta, se deben agrupar claramente en tres regiones distintas: los componentes que se conectan a la referencia digital  $GND_D$ , los que se conectan a la referencia del primario  $GND_1$ , y los que se conectan a la referencia del secundario  $GND_2$ . Existe una pequeña selección de componentes, como por ejemplo el aislador ISO7242C, que se encuentran entre dos de estas zonas, por formar parte del circuito de aislación de señal de la plataforma.

En la figura 2.9, que corresponde a ambas capas de cobre de la placa de circuito impreso, se pueden observar claramente las 3 distintas regiones en las que se divide, con  $GND_1$  a la izquierda,  $GND_2$  en la parte superior y  $GND_D$  a la derecha. Adicionalmente, en 2.9a están marcadas las regiones de la placa que se corresponden a cada uno de los seis bloques de la plataforma de la figura 2.1. Vamos a tratar la disposición de los circuitos de cada una de estas regiones a continuación.

### Región 1 - Convertidor CC-CC Conmutado

Esta región contiene todos los componentes que forman parte del circuito del convertidor CC-CC de puente completo de la plataforma de la figura 2.2, con partes conectadas a la tierra del primario  $GND_1$  y otras partes a la tierra del secundario  $GND_2$ , causado por la presencia de un transformador que provee aislación galvánica entre primario y secundario.

Abajo a la izquierda de esta región se encuentran los cuatro transistores MOSFET de potencia modelo IRFP150 (encapsulado THT tipo TO-247AC) que conforman el puente del lado primario, y hacia arriba se pueden ver los cuatro diodos de potencia modelo MUR860 (encapsulado THT tipo TO-220) del puente del lado secundario. Estos componentes se posicionaron deliberadamente en los bordes de la placa, ya que requieren grandes disipadores metálicos para manejar efectivamente el calor generado por los niveles de potencia que manejan.



**FIGURA 2.6** De izquierda a derecha: encapsulados tipo TO-247AC y TO-220, correspondientes a los transistores IRFP150 y diodos MUR860.

También se pueden ver en esta región dos marcas circulares grandes, que corresponden a los capacitores electrolíticos de filtro a la entrada y salida del convertidor, en paralelo a la pila de hidrógeno y a la carga variable respectivamente. Estos son capacitores de valores elevados (ambos de  $680 \mu F$ ), y en particular el de salida debe soportar tensiones pico que pueden superar los 120 V. Por estas razones, se seleccionaron capacitores blindados de 200 V de tensión máxima, que se consiguen en encapsulados muy grandes, en nuestro caso de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura, similar al que se observa en la figura 2.7.

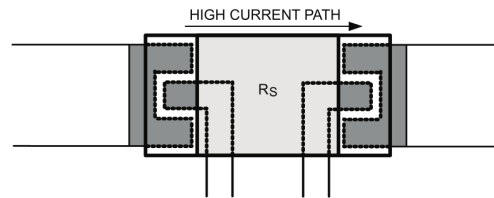
El inductor del filtro de salida y el transformador de alta frecuencia no se encuentran directamente sobre la placa, dado que son elementos de grandes dimensiones y aumentarían el tamaño de la PCB considerablemente si se colocaran en la misma. Por esta razón, se colocan terminales de alta tensión y corriente para conectar el primario y secundario del transformador, además del inductor de salida. Se utilizan dos conectores adicionales para conectar la pila de hidrógeno a la entrada y la carga variable a la salida.





**FIGURA 2.7** Capacitor electrolítico blindado de 25 mm de diámetro, similar al utilizado en la plataforma.

En la pista que conecta el terminal positivo de la pila de hidrógeno con el capacitor de filtro, se coloca la resistencia shunt de 4 mΩ utilizada por el sensor LM5056A para medir la corriente de pila. A diferencia del resto de las resistencias SMD, el shunt utiliza un encapsulado de dimensiones 2512, es decir 6.4 mm x 3 mm. Esto es necesario para poder realizar apropiadamente la conexión Kelvin de cuatro cables para la medición de la tensión shunt  $V_S$ : se conectan los cables que llevan la corriente por separado de los cables utilizados para medir la tensión, como se ve en la figura 2.8.



**FIGURA 2.8** Esquema de la conexión Kelvin de cuatro cables para la medición de la caída de tensión en la resistencia shunt.

**Anchos de Pista** Utilizando la ecuación 2.1 establecida por la norma IPC-2221, se calculan los anchos de pistas necesarios teniendo en cuenta el grosor  $H$  fijo de 0.035 mm y estableciendo la máxima elevación de temperatura de pista en 20 °C.

En el lado primario del convertidor, la máxima corriente que la pila de hidrógeno puede proveer es de aproximadamente 10 A, de manera que el ancho de pista del lado primario debe cumplir con el siguiente requerimiento:

$$W_{\text{primario}} > 4.72 \text{ mm} \quad (2.2)$$

Y en el lado secundario, dada la potencia máxima de 300 W y la tensión de salida fija de 75 V, la corriente máxima que circulará es de aproximadamente 4 A, por lo que el requerimiento de ancho de pista resulta:

$$W_{\text{secundario}} > 1.34 \text{ mm} \quad (2.3)$$

Con estos requerimientos en cuenta, los tamaños finales de las pistas de primario y secundario están resumidos en la siguiente tabla.

Ancho de Pista	
Primario	5 mm
Secundario	2 mm

**TABLA 2.2** Resumen de anchos de pista del circuito del convertidor CC-CC Conmutado.

## Región 2 - Circuito Driver

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

## Región 3 - Sistema de Medición

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

## Región 4 - Etapa de Aislación de Señal

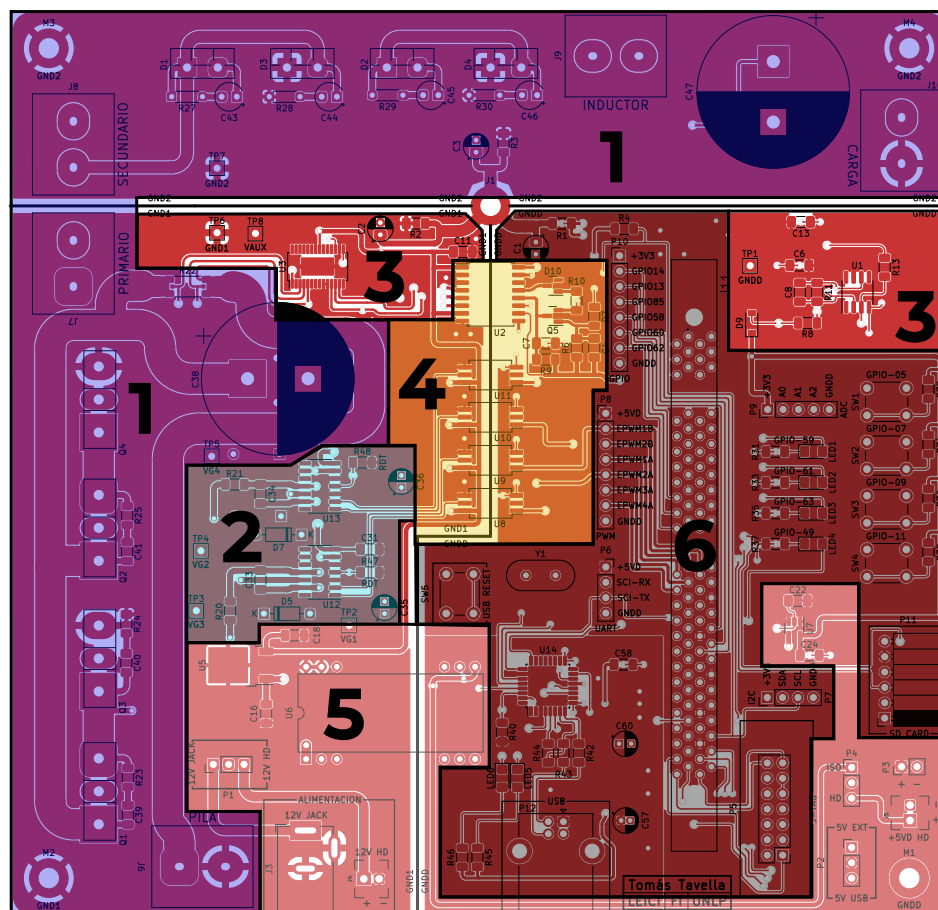
Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

## Región 5 - Sistema de Control

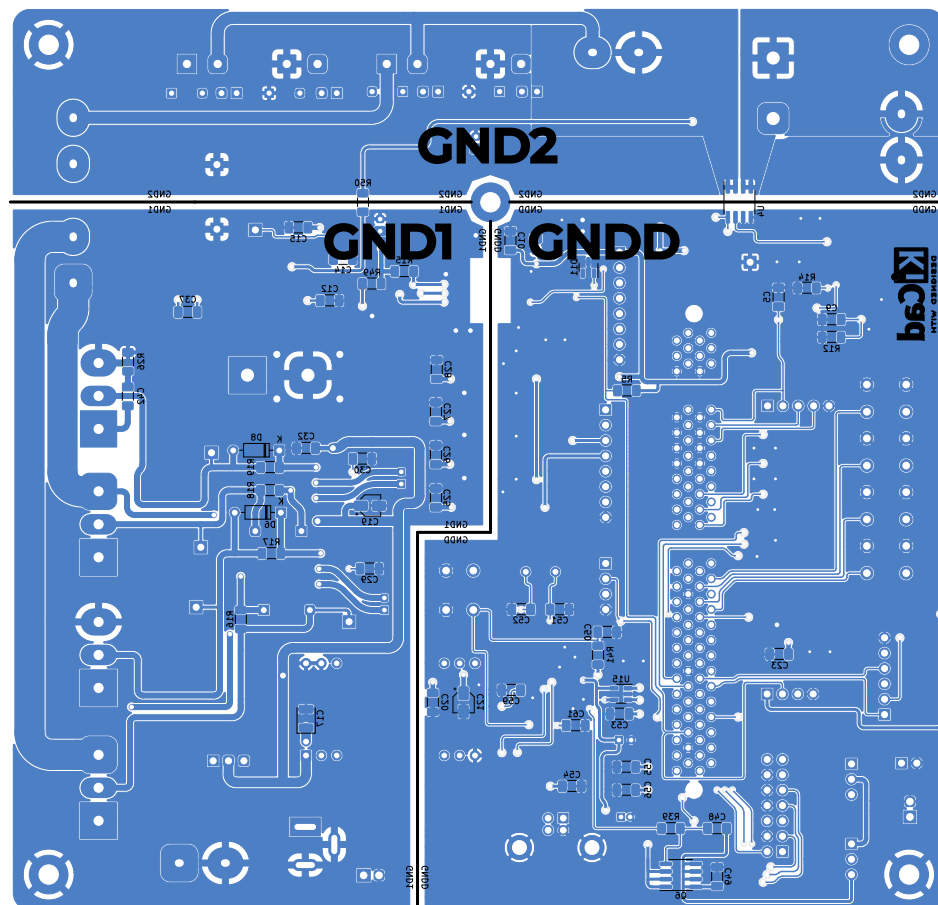
Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

## Región 6 - Circuito de Alimentación

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.



(a) Capa de cobre frontal, con los distintos bloques de la plataforma indicados.



(b) Capa de cobre trasera, con las tres distintas puestas a tierra.

**FIGURA 2.9** Diagrama de las distintas capas de cobre de la PCB.



# REFERENCIAS

- [1] Colin P. Morice et al. «Quantifying uncertainties in global and regional temperature change using an ensemble of observational estimates: The HadCRUT4 data set». En: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 117.D8 (2012). doi: 10.1029/2011JD017187.
- [2] UNEP Copenhagen Climate Centre (UNEP-CCC) UNEP. «Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On – A World of Climate Promises Not Yet Delivered – Executive Summary». En: *United Nations Environment Programme* (2021).
- [3] V. Smil. *Energy Transitions: Global and National Perspectives, 2nd Edition*. ABC-CLIO, LLC., 2016. ISBN: 978-1440853241.
- [4] Asmae Berrada y El Rachid Mrabet. *Hybrid Energy System Models*. Amsterdam: Academic Press, 2020. ISBN: 978-0-12-821403-9.
- [5] J.J. Talpone et al. «Experimental platform for development and Evaluation of hybrid generation systems based on fuel cells». En: *International Journal of Hydrogen Energy* 37 (2012), págs. 10346-10353.
- [6] Jorge L. Anderson, Paul F. Puleston y Pedro Fornaro. «Control de Sistema Híbrido de Energía Basado en Pilas de Combustible y Supercapacitores». En: ().